

# ДИФФУЗИЯ ФОСФОРА В КАРБИДЕ КРЕМНИЯ

*Е. Н. Мохов, Е. Д. Горнушкина, В. А. Дирик, В. В. Козловский*

Фосфор [<sup>1, 2</sup>] является донорной примесью в карбиде кремния. Однако его влияние на свойства этого материала изучено слабо, что объясняется значительными трудностями контролируемого получения образцов SiC <P>. Монокристаллы и эпитаксиальные слои SiC, легированные фосфором при выращивании, обычно содержат в качестве фоновой примеси азот на уровне, сравнимом с концентрацией фосфора [<sup>2</sup>], растворимость которого в карбиде кремния относительно невелика ( $C_p < 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ). Проблему получения образцов SiC <P> с малым содержанием азота частично удалось решить, вводя фосфор в SiC методом нейтронного трансмутационного легирования [<sup>3</sup>]. При этом удалось определить энергию ионизации фосфора в SiC, его положение в решетке [<sup>3</sup>]. Фосфор в карбиде кремния может быть введен также путем диффузии. Однако до сих пор в литературе отсутствуют сведения о параметрах диффузии фосфора в SiC. Известно [<sup>4</sup>], что заметная скорость диффузии примесей в карбиде кремния наблюдается лишь при температурах выше 2000 °C, при которых возможно частичное испарение образца. Скорость испарения заметно возрастает в присутствии паров фосфора [<sup>1</sup>], что сильно затрудняет изучение диффузии фосфора в SiC из паровой фазы. Чтобы избежать этого, в настоящей работе для оценки диффузионной подвижности фосфора в SiC использовались образцы, содержащие фосфор, введенный методом трансмутационного легирования на заряженных высокогенергетических частицах. Исследовалось изменение концентрационного профиля фосфора в образце при высокотемпературном отжиге.

Результаты, полученные подобной методикой, более адекватно отражают процесс твердофазной диффузии, поскольку в данном случае примесные центры не вводятся через границу раздела фаз, а диффузия осуществляется только за счет термической активации атомов, находящихся в регулярных позициях в объеме кристалла. Тем самым сводится к минимуму вероятность участия в диффузионном потоке состояний примеси, генерируемых на поверхности. Полученные данные характеризуют диффузию в собственном полупроводнике, так как концентрация трансмутированного фосфора  $C_p \ll n_i$  ( $n_i$  — плотность собственных носителей заряда).

При трансмутационном легировании вводятся также радиационные дефекты. Однако они в основном отжигаются при  $T < 2000^\circ\text{C}$  [<sup>5</sup>] и их влиянием на скорость миграции примеси при более высоких температурах, очевидно, можно пренебречь.

Ранее проведенное таким образом исследование диффузии фосфора в кремнии с применением ядерно-легированных слоев позволило получить данные, неплохо коррелирующие с известными из литературы [<sup>6</sup>].

Использовались образцы SiC политипа 6Н, выращенные методом Лели, преимущественно  $n$ -типа проводимости, легированные азотом, с концентрацией нескомпенсированных доноров ( $N_D - N_A = (2 \div 4) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ). В ряде экспериментов применялись также сильно легированные алюминием ( $C_{Al} = 5 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ ) образцы дырочного SiC.

Для трансмутационного введения фосфора образцы облучались альфа-частицами с энергией 16 и 20 МэВ при плотности тока  $j = 0.1 \text{ мкА/см}^2$ . Для получения более резкого концентрационного профиля фосфора облучение проводилось при косом падении пучка под углом  $\varphi = 6 \div 30^\circ$ . Трансмутационное легирование осуществлялось за счет ядерной реакции  $^{29}\text{Si}(\alpha, p) ^{32}\text{P}$ .

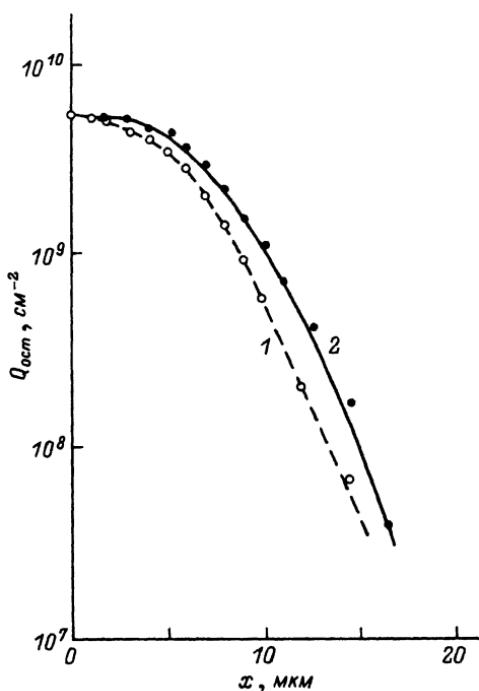


Рис. 1. Профиль остаточной концентрации фосфора в  $n$ -SiC, облученном альфа-частицами.

Энергия альфа-частиц 20 МэВ, угол падения пучка  $\varphi = 6$ . 1 — до отжига, 2 — после отжига при  $2400^\circ\text{C}$  в течение 3 ч.

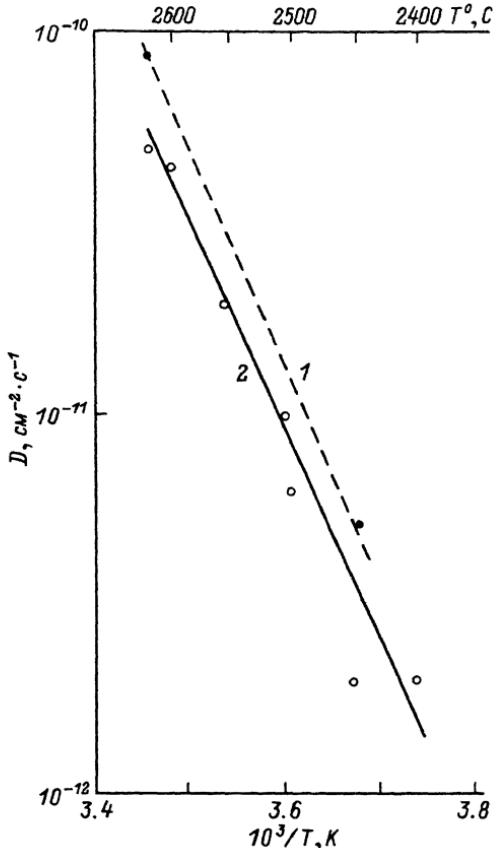


Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузии фосфора в SiC от температуры.

1 —  $p$ -тип проводимости, легированный Al с  $(N_A - N_D) = 5 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ ; 2 —  $n$ -тип проводимости, легированный азотом с  $(N_D - N_A) = 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

После облучения образцы отжигались в замкнутых графитовых контейнерах в атмосфере аргона при температуре  $2000—2600^\circ\text{C}$ . Для уменьшения испарения образцы располагались в изотермической зоне, окруженной со всех сторон мелкодисперсным порошком SiC. Время отжига варьировалось от 30 мин до 10 ч. Толщина испаренного слоя SiC в процессе отжига не превышала 2—3 мкм.

Концентрационный профиль фосфора определялся путем измерения остаточной  $\beta$ -активности образцов при последовательном снятии поверхностных слоев методом химического травления в расплаве щелочи KOH. Толщина слоев  $\sim 1$  мкм. Профиль радиоактивного фосфора одновременно анализировался и в контрольном образце, который не подвергался диффузионному отжигу.

Согласно полученным результатам, заметные изменения концентрационного профиля выявляются лишь при температурах отжига выше  $2400^\circ\text{C}$  (рис. 1). Из полученных данных определялся коэффициент диффузии в предположении, что выполняется закон Фика. Для этого рассматривалась одномерная диффузия в полупространстве с непроницаемой границей. Для остаточного количества вещества  $Q(x, t)$  имеем [6]

$$Q(x, t) = Q_0 \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{Dt}} + \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_0^\infty Q(\xi, 0) \left[ \exp \left( -\frac{(x-\xi)^2}{4Dt} \right) - \right]$$

$$-\exp \left( -\frac{(x+\xi)^2}{4Dt} \right) d\xi,$$

где  $Q(\xi, 0)$  — исходный профиль остаточного количества примеси. Граничные условия:  $Q(0, t) = Q_0 = \text{const}$ ,  $Q(x, 0) = Q(\xi, 0)$ ,  $Q(\infty, t) = 0$ .

Из этого соотношения был найден коэффициент диффузии фосфора, температурная зависимость которого для  $n\text{-SiC}$  <N> описывается выражением

$$D_p = 1.3 \cdot 10^{10} \exp(-11.6 \text{ эВ}/kT) \text{ см}^2/\text{с}.$$

В сильнолегированном алюминием  $p\text{-SiC}$  скорость диффузии фосфора несколько выше (рис. 2).

Обращает на себя внимание очень высокая величина энергии активации диффузии фосфора, которая выше, чем для самодиффузии в  $n\text{-SiC}$  кремния ( $\Delta E = 8.18$  эВ) [7] и углерода ( $\Delta E = 8.2$  эВ) [8].

Отметим, что в исследованном диапазоне температур  $D_p$  по величине ближе к значению коэффициента самодиффузии кремния. В то же время коэффициент самодиффузии углерода на 2—3 порядка выше [8]. Остюда можно было бы предположить, что миграция фосфора осуществляется по вакансиям Si. Однако в рамках этой модели трудно понять причину более высокой скорости миграции фосфора в сильнолегированном  $p\text{-SiC}$  <Al> по сравнению с образцами  $n$ -типа проводимости. Известно, что вакансии кремния в SiC заряжены отрицательно [4, 7, 8] и, следовательно, их концентрация должна снижаться с увеличением концентрации акцепторной примеси, приводя к уменьшению подвижности P. На самом деле наблюдается обратный эффект, свидетельствующий скорее в пользу механизма диффузии фосфора с участием углеродных вакансий. В этой связи отметим, что энергия активации диффузии фосфора не сильно отличается от ранее установленной величины  $\Delta E$  для диффузии азота [9], который замещает в решетке SiC углерод и, очевидно, мигрирует по вакансиям углерода.

#### Список литературы

- [1] Lilov S. K. // Cryst. Res. and Technol. 1982. V. 17. N 1. P. K17—K20.
- [2] Мохов Е. Н., Усманова М. М., Юлдашев Г. Ф., Махмудов Б. С. // Изв. АН СССР. Неорг. мат. 1981. Т. 17. № 2. С. 258—261.
- [3] Вейнгер А. И., Забродский А. Г., Ломакина Г. А., Мохов Е. Н. // ФТГ. 1986. Т. 28. № 6. С. 1659—1664.
- [4] Vodakov Yu. A., Mokhov E. N. // Silicon Carbide-1973. South Carolina Univ. Press, 1974. P. 508—519.
- [5] Гирка А. И., Мокрушин А. Д., Мохов Е. Н., Осадчие В. М., Свирида С. В., Шишкун А. В. // ЖЭТФ. 1990. Т. 97. № 2. С. 578—590.
- [6] Горнушкина Е. Д., Дибик В. А., Козловский В. В., Малкович Р. Ш. // ФТП. 1991. Т. 25. № 11. С. 2044—2046.
- [7] Hong J. D., Davis R. F., Newbury D. E. // J. Mater. Sci. 1981. V. 16. N 9. P. 2485—2496.
- [8] Hong J. D., Davis R. F. // J. Amer. Ceram. Soc. 1980. V. 63. N 5. P. 546—552.
- [9] Kroko L. J., Milnes A. G. // Sol. St. Electron. 1966. V. 9. N 11/12. P. 1125—1134.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
28 января 1992 г.